



SEMITRANS® 2

IGBT Modules

SKM 100GB123D

SKM 100GAL123D

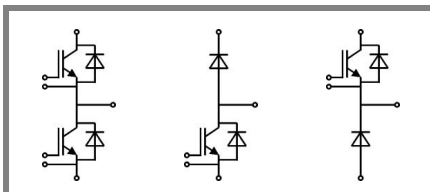
SKM 100GAR123D

Features

- MOS input (voltage controlled)
- N channel, Homogeneous Si
- Low inductance case
- Very low tail current with low temperature dependence
- High short circuit capability, self limiting to $6 \times I_{Cnom}$
- Latch-up free
- Fast & soft inverse CAL diodes
- Isolated copper baseplate using DCB Direct Copper Bonding Technology
- Large clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)

Typical Applications

- AC inverter drives
- UPS



GB

GAL

GAR

Absolute Maximum Ratings				$T_c = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified	
Symbol	Conditions			Values	Units
IGBT					
V_{CES}	$T_j = 25^\circ\text{C}$			1200	V
I_C	$T_j = 150^\circ\text{C}$	$T_{case} = 25^\circ\text{C}$		100	A
		$T_{case} = 80^\circ\text{C}$		90	A
I_{CRM}	$I_{CRM} = 2 \times I_{Cnom}$			150	A
V_{GES}				± 20	V
t_{psc}	$V_{CC} = 600\text{ V}; V_{GE} \leq 20\text{ V}; T_j = 125^\circ\text{C}$ $V_{CES} < 1200\text{ V}$			10	μs
Inverse Diode					
I_F	$T_j = 150^\circ\text{C}$	$T_{case} = 25^\circ\text{C}$		95	A
		$T_{case} = 80^\circ\text{C}$		65	A
I_{FRM}	$I_{FRM} = 2 \times I_{Fnom}$			150	A
I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms; sin.}$	$T_j = 150^\circ\text{C}$		720	A
Freewheeling Diode					
I_F	$T_j = 150^\circ\text{C}$	$T_{case} = 25^\circ\text{C}$		130	A
		$T_{case} = 80^\circ\text{C}$		90	A
I_{FRM}	$I_{FRM} = 2 \times I_{Fnom}$			200	A
I_{FSM}	$t_p = 10\text{ ms; sin.}$	$T_j = 150^\circ\text{C}$		900	A
Module					
$I_{t(RMS)}$				200	A
T_{vj}				- 40... + 150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}				- 40... + 125	$^\circ\text{C}$
V_{isol}	AC, 1 min.			2500	V

Characteristics			T _c = 25 °C, unless otherwise specified			
Symbol	Conditions		min.	typ.	max.	Units
IGBT						
V _{GE(th)}	V _{GE} = V _{CE} , I _C = 2 mA		4,5	5,5	6,5	V
I _{CES}	V _{GE} = 0 V, V _{CE} = V _{CES}	T _j = 25 °C		0,1	0,3	mA
V _{CE0}		T _j = 25 °C		1,4	1,6	V
		T _j = 125 °C		1,6	1,8	V
r _{CE}	V _{GE} = 15 V	T _j = 25°C		14,6	18,6	mΩ
		T _j = 125°C		20	25,3	mΩ
V _{CE(sat)}	I _{Cnom} = 75 A, V _{GE} = 15 V	T _j = °C _{chiplev.}		2,5	3	V
C _{ies}	V _{CE} = 25, V _{GE} = 0 V	f = 1 MHz		5	6,6	nF
C _{oes}				0,72	0,9	nF
C _{res}				0,38	0,5	nF
Q _G	V _{GE} = -8V - +20V			750		nC
R _{Gint}	T _j = °C			5		Ω
t _{d(on)}	R _{Gon} = 15 Ω	V _{CC} = 600V I _{Cnom} = 75A T _j = 125 °C V _{GE} = ± 15V		30	60	ns
t _r				70	140	ns
E _{on}				10		mJ
t _{d(off)}	R _{Goff} = 15 Ω			450	600	ns
t _f				70	90	ns
E _{off}				8		mJ
R _{th(j-c)}	per IGBT				0,18	K/W



SEMITRANS® 2

IGBT Modules

SKM 100GB123D

SKM 100GAL123D

SKM 100GAR123D

Features

- MOS input (voltage controlled)
- N channel, Homogeneous Si
- Low inductance case
- Very low tail current with low temperature dependence
- High short circuit capability, self limiting to $6 \times I_{cnom}$
- Latch-up free
- Fast & soft inverse CAL diodes
- Isolated copper baseplate using DCB Direct Copper Bonding Technology
- Large clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)

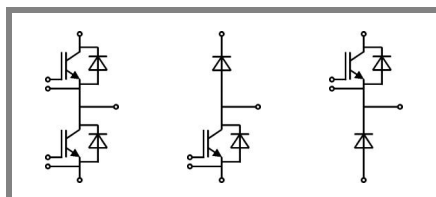
Typical Applications

- AC inverter drives
- UPS

Characteristics					
Symbol	Conditions	min.	typ.	max.	Units
Inverse Diode					
$V_F = V_{EC}$	$I_{Fnom} = 75 \text{ A}; V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}_{chiplev.}$	2	2,5	V
		$T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}_{chiplev.}$	1,8		V
V_{F0}		$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1,1	1,2	V
		$T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$			V
r_F		$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	12	17	mΩ
		$T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$			mΩ
I_{RRM}	$I_{Fnom} = 75 \text{ A}$	$T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	40		A
Q_{rr}	$di/dt = 800 \text{ A}/\mu\text{s}$		3		μC
E_{rr}	$V_{GE} = 0 \text{ V}; V_{CC} = 600 \text{ V}$				mJ
$R_{th(j-c)D}$	per diode			0,5	K/W
Freewheeling Diode					
$V_F = V_{EC}$	$I_{Fnom} = 100 \text{ A}; V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}_{chiplev.}$	2	2,5	V
		$T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}_{chiplev.}$	1,8		V
V_{F0}		$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1,1	1,2	V
		$T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$			V
r_F		$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	9	13	V
		$T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$			V
I_{RRM}	$I_{Fnom} = 100 \text{ A}$	$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	50		A
Q_{rr}	$di/dt = 1000 \text{ A}/\mu\text{s}$		5		μC
E_{rr}	$V_{GE} = 0 \text{ V}; V_{CC} = 600 \text{ V}$				mJ
$R_{th(j-c)FD}$	per diode			0,36	K/W
Module					
L_{CE}				30	nH
$R_{CC'+EE'}$	res., terminal-chip	$T_{case} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	0,75		mΩ
		$T_{case} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	1		mΩ
$R_{th(c-s)}$	per module			0,05	K/W
M_s	to heat sink M6		3	5	Nm
M_t	to terminals M5		2,5	5	Nm
w				160	g

This is an electrostatic discharge sensitive device (ESDS), international standard IEC 60747-1, Chapter IX.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. No warranty or guarantee expressed or implied is made regarding delivery, performance or suitability.



GB

GAL

GAR

SKM 100GB123D



SEMITRANS® 2

IGBT Modules

SKM 100GB123D
SKM 100GAL123D
SKM 100GAR123D

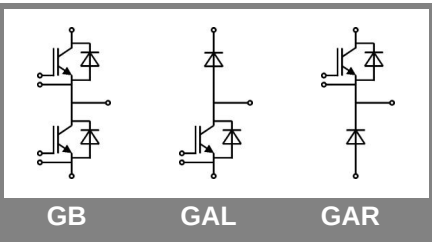
Features

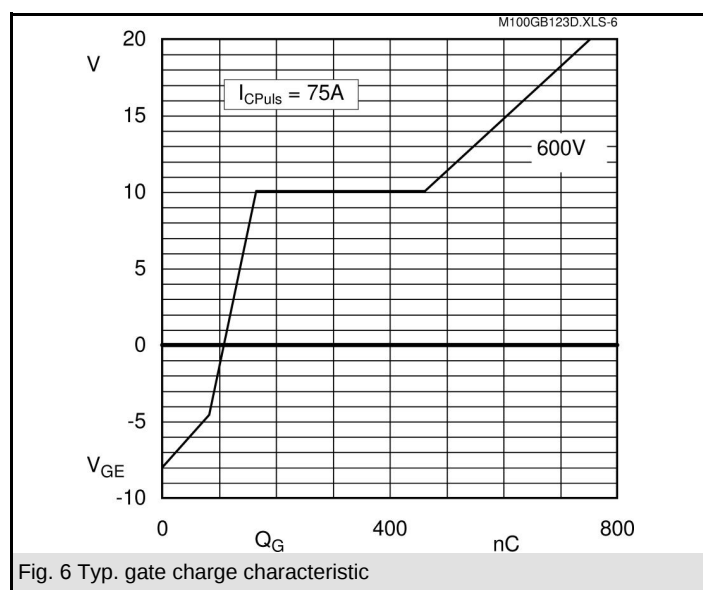
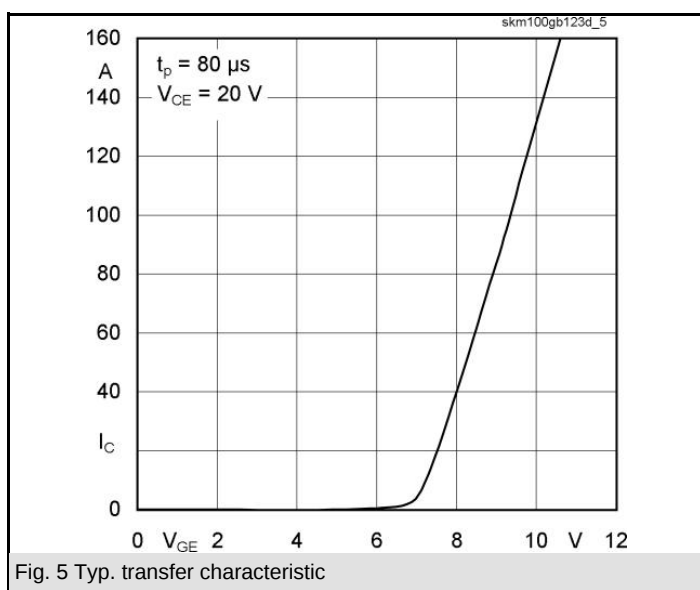
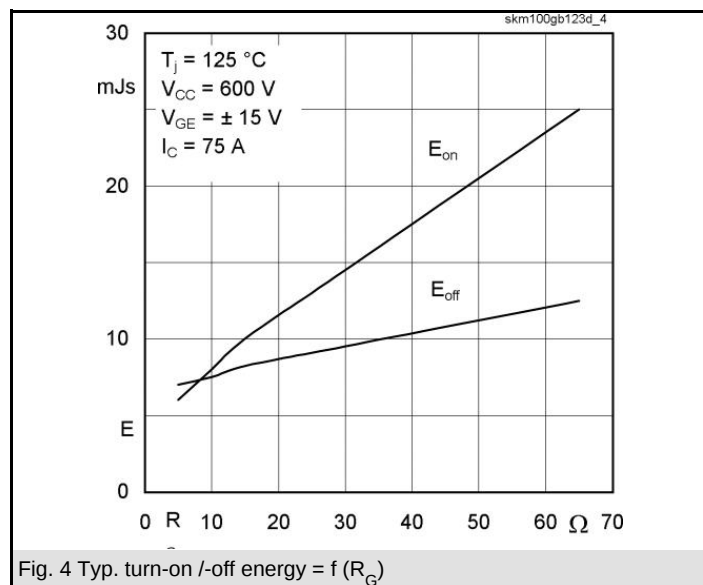
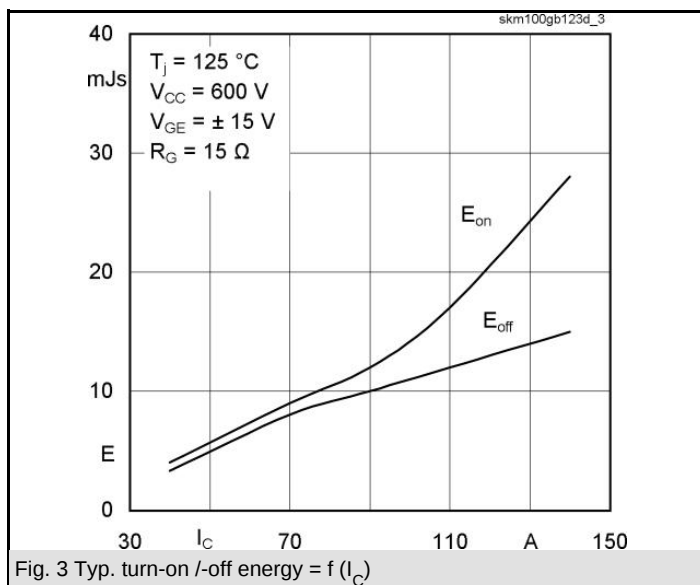
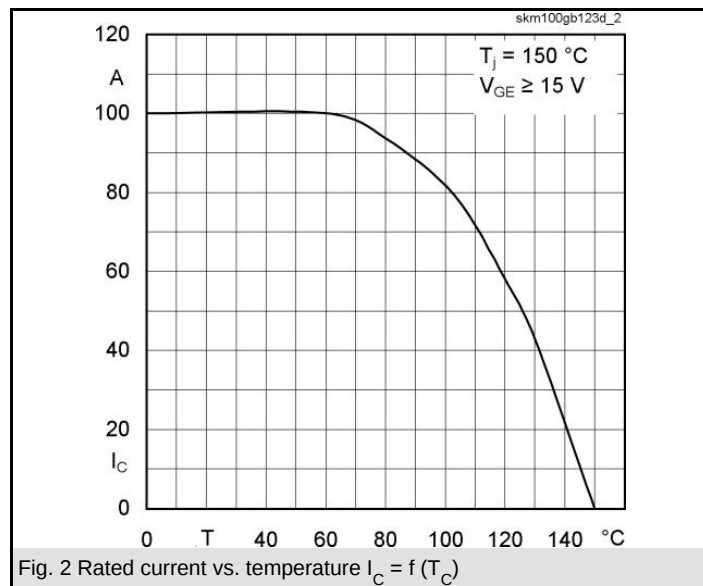
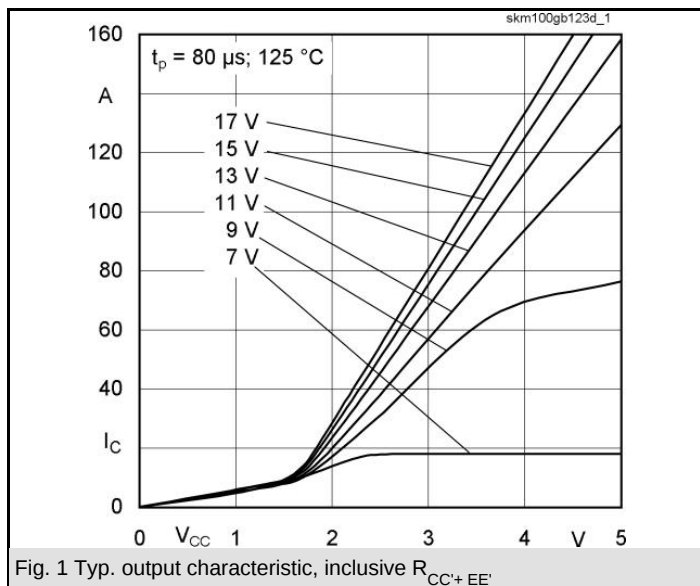
- MOS input (voltage controlled)
- N channel, Homogeneous Si
- Low inductance case
- Very low tail current with low temperature dependence
- High short circuit capability, self limiting to $6 \times I_{cnom}$
- Latch-up free
- Fast & soft inverse CAL diodes
- Isolated copper baseplate using DCB Direct Copper Bonding Technology
- Large clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)

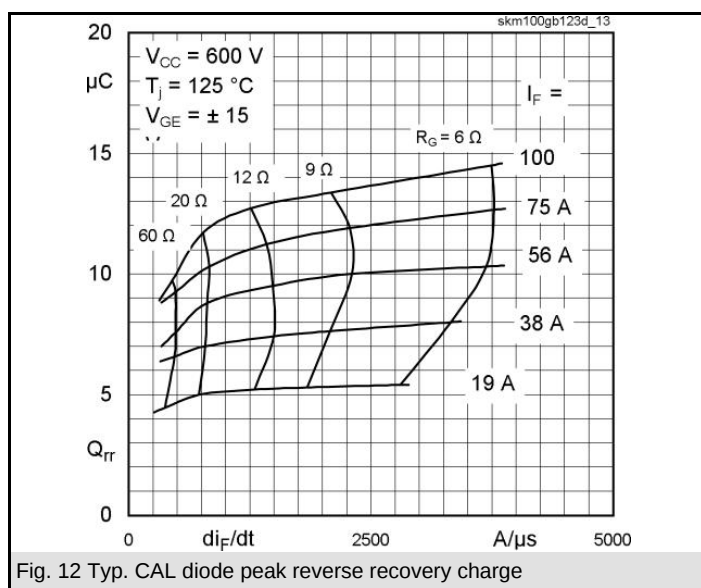
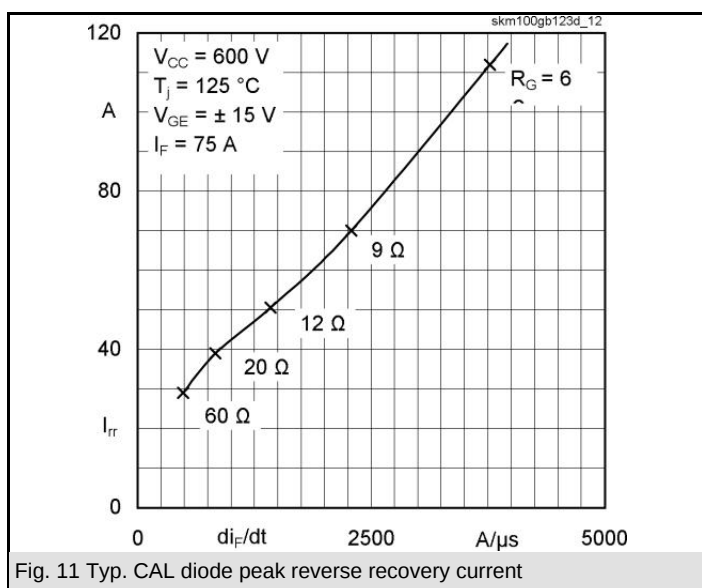
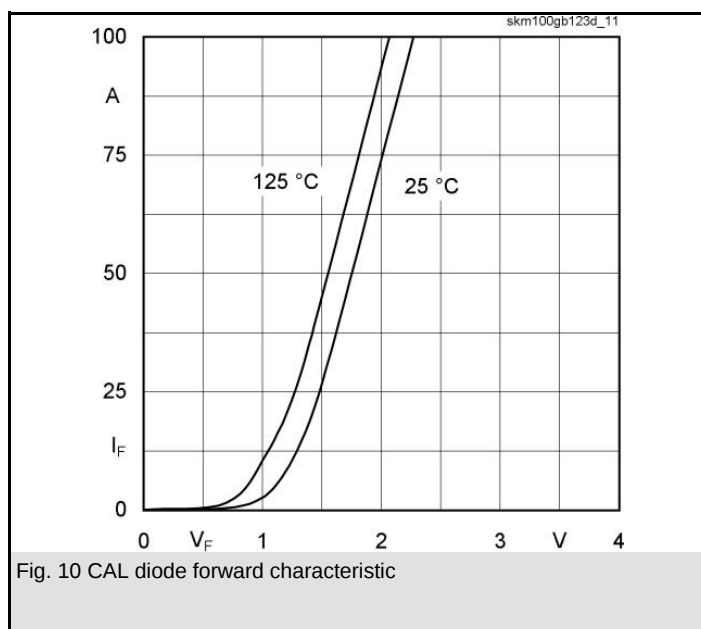
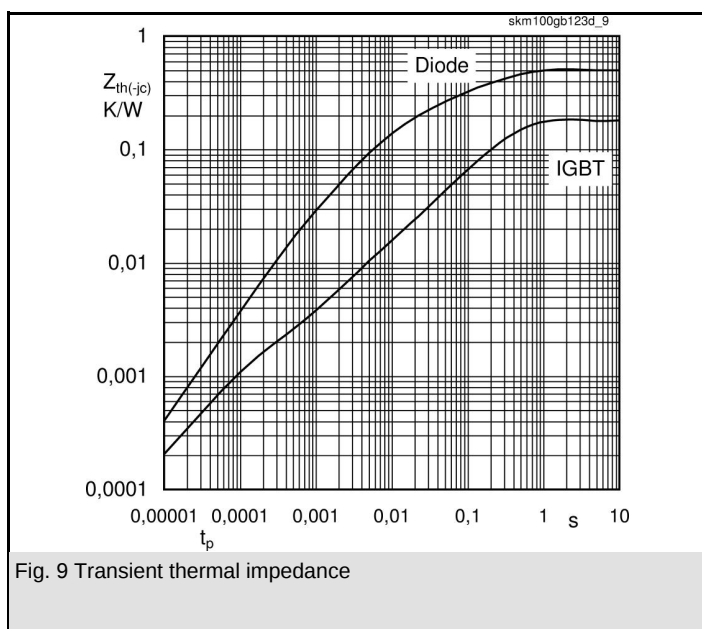
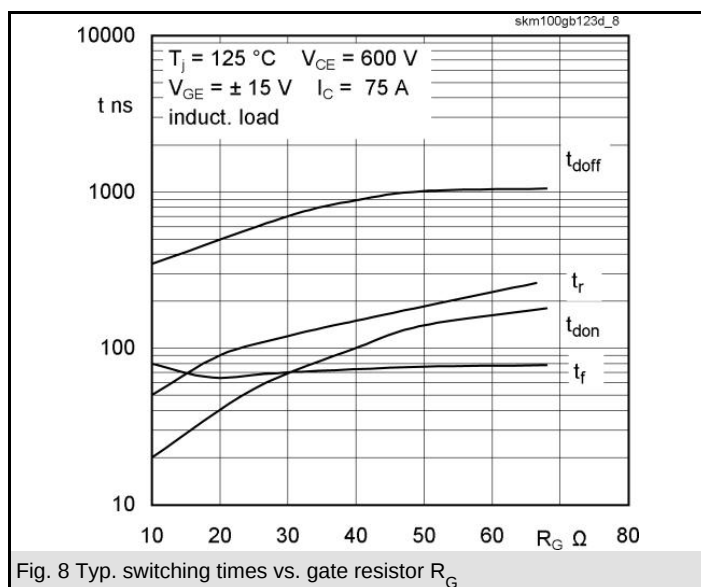
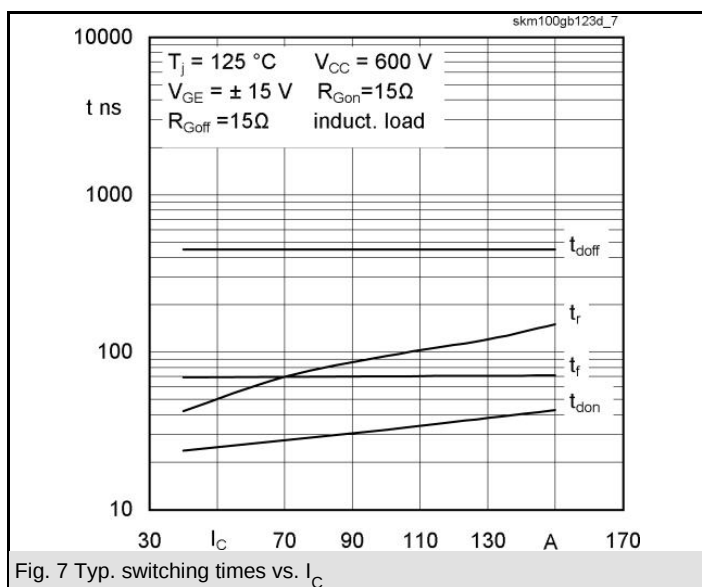
Typical Applications

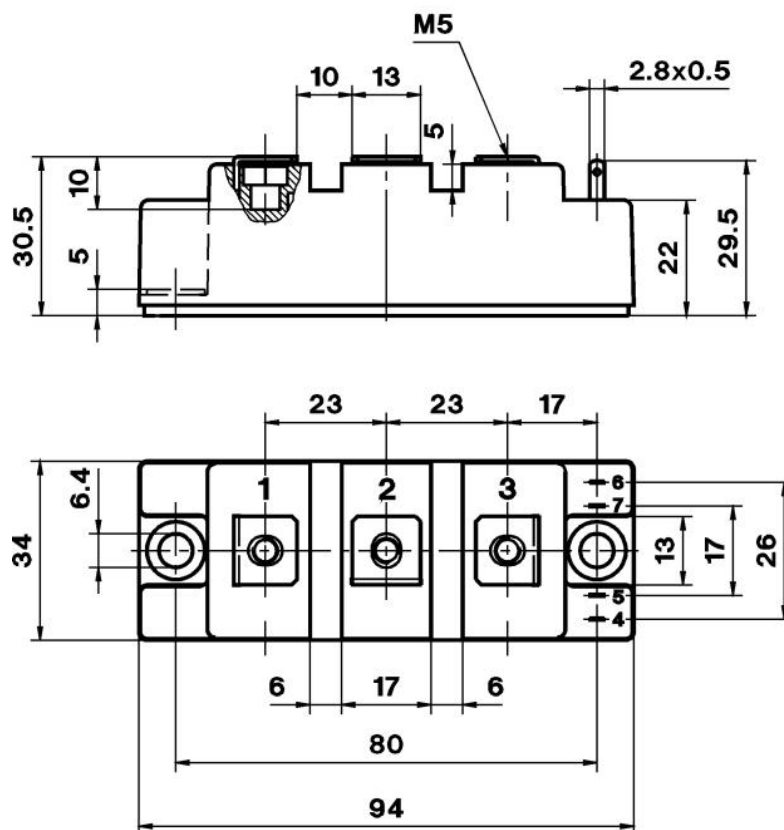
- AC inverter drives
- UPS

Z_{th}			
Symbol	Conditions	Values	Units
$Z_{th(j-c)I}$			
R_i	$i = 1$	162	mk/W
R_i	$i = 2$	14	mk/W
R_i	$i = 3$	2,7	mk/W
R_i	$i = 4$	1,3	mk/W
τ_{u_i}	$i = 1$	0,204	s
τ_{u_i}	$i = 2$	0,0242	s
τ_{u_i}	$i = 3$	0,0013	s
τ_{u_i}	$i = 4$	0	s
$Z_{th(j-c)D}$			
R_i	$i = 1$	320	mk/W
R_i	$i = 2$	150	mk/W
R_i	$i = 3$	0,0265	mk/W
R_i	$i = 4$	3,5	mk/W
τ_{u_i}	$i = 1$	0,05	s
τ_{u_i}	$i = 2$	0,0104	s
τ_{u_i}	$i = 3$	0,0034	s
τ_{u_i}	$i = 4$	0,0003	s

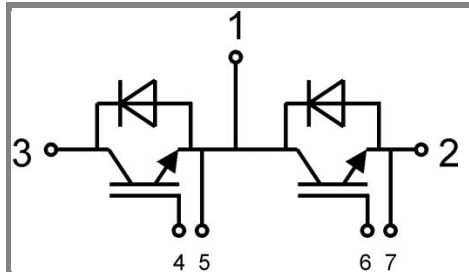






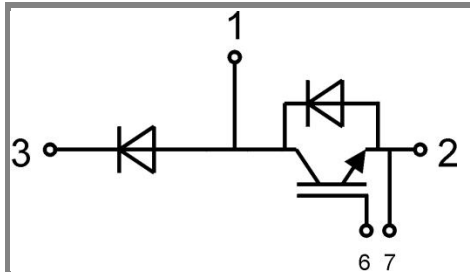


Case D 61



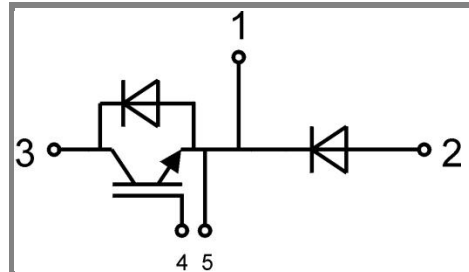
GB

Case D 61



GAL

Case D 62 (→ D 61)



GAR

Case D 63 (→ D 61)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.